(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 4 月 7 日(07.04.2016)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2016/051636 A1

(51) 国際特許分類:
C09K 3/14 (2006.01) *C09G 1/02* (2006.01)
B24B 37/00 (2012.01) *H01L 21/304* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2015/003754

(22) 国際出願日: 2015 年 7 月 27 日(27.07.2015)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2014-200720 2014 年 9 月 30 日(30.09.2014) JP

(71) 出願人: 株式会社フジミインコーポレーテッド (FUJIMI INCORPORATED) [JP/JP]; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１ Aichi (JP).

(72) 発明者: 佐藤　剛樹 (SATO, Takeki); 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１　株式会社フジミインコーポレーテッド内 Aichi (JP). 坂部　晃一 (SAKABE, Koichi); 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１　株式会社フジミインコーポレーテッド内 Aichi (JP).

(74) 代理人: 森　哲也, 外 (MORI, Tetsuya et al.); 〒1056032 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号　城山トラストタワー３２階　特許業務法人日栄国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

WO 2016/051636 A1

(54) **Title**: POLISHING COMPOSITION, METHOD FOR MANUFACTURING SAME, AND POLISHING METHOD

(54) 発明の名称 : 研磨用組成物及びその製造方法並びに研磨方法

(57) **Abstract**: Provided is a polishing composition whereby a polishing object such as simple silicon, a silicon compound, or a metal, particularly a polishing object including tungsten, can be polished at a high polishing speed. The polishing composition contains colloidal silica in which an organic acid is immobilized on the surface thereof, hydrogen peroxide, and a salt. The salt is ammonium nitrate and/or ammonium sulfate.

(57) 要約: 単体シリコン、シリコン化合物、金属等の研磨対象物、特にタングステンを含む研磨対象物を高研磨速度で研磨することが可能な研磨用組成物を提供する。研磨用組成物は、表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカと、過酸化水素と、塩とを含有する。塩は、硝酸アンモニウム及び硫酸アンモニウムの少なくとも一つである。